

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION	No.	IS-9871C 来歴 / REV.	1
	頁 / PAGE	1 / 3	
標 題 : 9871S/B シリーズ 2.5mmピッチ ボード トゥ ボード コネクタ SUBJECT : SERIES 9871S/B 2.5mm pitch board to board connector	制定年月日 / ISSUE DATE	2011 - 10 - 05	
	改訂年月日 / REVISED DATA	2011 - 11 - 24	

1. 適用範囲 / Scope

本仕様書は、イリソ電子工業株式会社製 9871S/B シリーズ 2.5mmピッチ ボード トゥ ボード コネクタに関する仕様及び性能上の必要事項について規定する。

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS CO.,LTD. series 9871S/B 2.5mm pitch board to board connector

適合ソケット / Applied socket : IMSA - 9871S - *** - **

適合プラグ / Applied plug : IMSA - 9871B - *** - **

2. 形状、寸法及び材質 / Configurations dimensions and materials

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。

See the product drawing attached.

3. 定格 / Rating

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
3-1	使用温度範囲 / Operating temperature limit	IEC : 603-1	-40~+105℃	/
3-2	定格電圧 / Voltage rating		125V (AC,DC)	
3-3	定格電流 / Amperage rating		3A	

4. 試験環境 / Environmental condition

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
4-1	環境条件 / Environmental qualification	JIS : C60068-1-5-3 (IEC : 60068-1)	常温 : 15~35℃ 常湿 : 25~85%RH	/

5. 電気的特性 / Electrical performances

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
5-1	接触抵抗 / Contact resistance	IEC : 60512	短絡電流 / current:1mA 最大開放電圧 / voltage:20mV 周波数 / frequency:1 k Hz	初期値 : 40mΩ以下 各試験後 : 60mΩ以下 Initial : 40mΩ or below After each test : 60mΩ or below
5-2	耐電圧 / Dielectric withstanding Voltage	IEC : 60512-4-1	AC250V ,60±5s	絶縁破壊等異常のない事。 Should not have any changes.
5-3	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	IEC : 60512-3-1	DC250V ,60±5s	初期値 : 500MΩ以上 Initial : 500MΩ MIN. 試験後 100MΩ以上 / After the examination : 100MΩ MIN.

6. 機械的特性 / Functional performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
6-1	コンタクトの保持力 / Contact retention force	IEC : 60512-16-20	25mm/min	4.9N 以上 4.9N MIN.
6-2	ポストの保持力 / Post retention force	IEC : 60512-16-20	25mm/min.	1.96N 以上 1.96N MIN.
6-3	結合力及び離脱力 / Engaging and separating forces	IEC : 60512-13-1	25mm/min	初期値にて / Initial 挿入力 : 2.45N以下 / 極 抜去力 : 0.20N 以上 / 極 Insertion force : 2.45N MAX / terminal. Extraction force : 0.20N MIN / terminal

6. 機械的特性 / Functional performance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
6-4	挿抜耐久性 (繰り返し動作) / Insertion/extraction Endurance	JIS : C5402(6.3)	繰り返し動作回数 / 20回 Operation frequency/20 times	5-1,9-1
6-5	振動試験 / Vibration test	IEC : C60068-2-6	振動周波数/Vibrational frequency : 10~55~10Hz 振幅 / amplitude : 1.5mm, スイープ時間 / Sweep time : 1minute 方向 / Direction : X,Y,Z 2 h	試験中の瞬断 / Discontinuity : ≤ 1 μs 5-1,,9-1
6-6	衝撃試験 / Shock test	IEC : C60068-2-27	加速度 / Acceleration : 490ms ² 作用時間 / Time : 11m s 回数 / Time : 3回 / Times	試験中の瞬断 / Discontinuity : ≤ 1 μs 5-1, 9-1

7. 耐候性試験 / Weatherability test

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
7-1	高温試験 / Dry heat	IEC : 60068-2-2	温度 / Temperature : 105±2℃ 時間 / Time : 1,000h	5-1,9-1
7-2	高温高湿試験 / Dump heat steady state	IEC : 68-2-3	湿度 / : 90~95% 温度 / Temperature : 60±2℃ 時間 / Time : 1,000h	5-1,9-1
7-3	塩水噴霧試験 / Salt mist	IEC : 68-2-11	水温 / Temperature : 35±2℃ 濃度 / Percentage humidity : 5±1% 時間 / Time : 48h	5-1,9-1
7-4	SO ₂ ガス試験 / SO ₂ gas test		温度 / Temperature : 40±2℃ 相対湿度 / Percentage humidity : 75% RH 濃度 / Cardinality : 20±3ppm 時間 / Time : 96h	5-1,9-1
7-5	H ₂ Sガス試験 / H ₂ S gas test		温度 / Temperature : 40±2℃ 相対湿度 / Percentage humidity : 75% RH 濃度 / Cardinality : 3±1ppm 時間 / Time : 96h	5-1,9-1
7-6	温度サイクル試験 / Change of temperature	IEC:60068-2-14 (JIS C0025)	温度 / Temperature : -55~+105℃ サイクル数 / Cycle : 500 cycle (1サイクル / 1cycle : 1h)	5-1,9-1

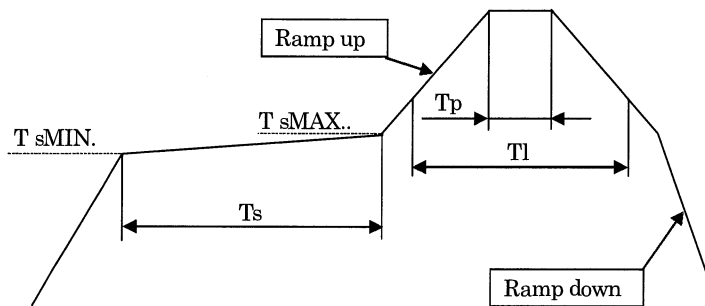
8. その他 特性 / Other tests

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
8-1	はんだ付け試験法 (平衡法) / Solderability test (wetting balance method)	IEC : 68-2-20 IEC : 60068-2-58 IEC : 68-2-44 IEC : 68-2-54	温度 : 245℃±5℃, 3±0.5s	はんだ付着面積 / Soldering area ≥95%
8-2	半田耐熱性 / Resistance to Soldering heat	JEDEC : J-STD-020C IEC : 68-2-20 IEC : 60068-2-58 IEC : 68-2-44 [JIS C60068-2-58-8.2.4 JIS C60068-2-58-8.1.2]	①手半田/Plug manual soldering 半田温度 / Temperature : 350℃±5℃. 時間 / Time : 3s±0.5 s ②リフロー/Socket reflow-Soldering 温度 / Temperature : リフロー温度条件参照 / See temperature chart 時間 / Time : リフロー温度条件参照 / See temperature chart 回数 / Times : 2回 ・温度は製品上面の温度とする。 The temperature shall be measured on the surface of the product. ・フラックスについては IRISO 選定品使用/ IRISO selection goods use of flux.	5-1, 9-1
8-3	温度上昇試験 / Raise of temperature test		最大許容電流を通電し、熱電対法にてコネクタの温度 上昇を測定する The connector shall be operated in the maximum raise of current and measured raise of the temperature at contact point.	温度上昇 : 40℃以下 / Raise of temperature : 40℃ or below

8-2-②

・リフロー温度条件 / Reflow temperature

プロファイル条件 / Profile Feature	鉛フリーリフロー温度条件 / Sn-Pb Eutectic Assembly
温度上昇 / Ramp up Rate (TSmax to Tp)	: 1~4 °C / s
・ Pre-heat T _{smin.} T _{smax.} time(T _{smin.} to T _{smax.})	: 170°C MIN : 190°C MAX : 60-180s
T _l 温度 / temperature 時間 / time	: 225°C MIN. : 60~150s
T _p (ピーク / Peak) 温度 / temperature 時間 / time	: 260°C MAX. (255°C MIN.) : 10s MAX



9. 外観 / Appearance

No.	項目 / Items	方法 / method	条件 / conditions	規格 / specifications
9-1	外観 / Appearance	IEC : 512-2		実使用上、問題無き事 Should not have any problems.

10. 製品の保管期間 Term of a guarantee

製造日より1年とする。

1 year from production day.

11. 保管条件 Storage condition

室内で温度-10~+40°C、湿度75%RH以下の相対湿度で保管して下さい。

Shall be storage in the house at -10~+40°C,75%RH max.

12. 使用上の注意 Attention of using connector

嵌合について Mating of connector

- ・斜め嵌合やこじめる事の無い様に真っ直ぐにゆっくりと挿抜して下さい。

When the connector is mating,connector shall not be twisted,and then mated it slowly.

接続方法について Connect of connector

- ・コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。

It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.

- ・コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビスにて確実に固定して下さい。

When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.

- ・コネクタにかかる加速度は、セット組立品に於いても43.12m/s²以下として下さい (共振振動が加わらない事)。

Acceleration of connector : 43.12m/s² or less.(The connector shall not be added to resonance acceleration.)